

N700B-s

Non-Silicone Thermal Conductive Pad

LiPOLY N700B-s はノンシリコン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサの揮発は少ないので、電子回路接点不良という状況はありません。N700B-s は良い熱伝導性があり、熱伝導率は 3.0W / m*K です。熱抵抗も低いて、光学製品や敏感な電子部品の使用には適合です。

■ 製品の特性

/ 熱伝導率: 3.0 W/m*K
/ ノンシリコン材料
/ 接触熱抵抗が小さい
/ 電気絶縁
/ 優れる熱伝導率
/ 光学デバイスに適合

■ 製品アプリケーション

/ ハードディスク
/ 光学デバイス
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 製品の形

/ シート状
/ フォーミング形



■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	N700B-s	TEST METHOD	UNIT
Color	Red	Visual	-
Surface tack 2-side/1-side	2	-	-
Thickness	Customized	ASTM D374	mm
Density	2.6	ASTM D792	g/cm³
Hardness	60	ASTM D2240	Shore OO
Tensile Strength	1.0	ASTM D412	Kgf/cm²
Application temperature	-60~125	-	°C
Low molecular Siloxane (D3 to D20 total)	N.D	Gas Chromatography	%
Outgassing CVCN (wt%)	0.0072	By LiPOLY	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
COMPRESSION@1.0mm			
Deflection @10 psi	27	ASTM D5470 modify	%
Deflection @20 psi	42	ASTM D5470 modify	%
Deflection @30 psi	51	ASTM D5470 modify	%
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	16	ASTM D149	KV/mm
Surface resistivity	>10 ¹¹	ASTM D257	Ohm
Volume resistivity	>10 ¹⁰	ASTM D257	Ohm-m
THERMAL			
Thermal conductivity	3.0	ASTM D5470	W/m*K
Thermal impedance@10 psi	0.671	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@20 psi	0.543	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@30 psi	0.392	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@40 psi	0.236	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@50 psi	0.169	ASTM D5470	°C-in²/ W

The chemical formula indicates that if Cyclic polydimethylsiloxane (HO-[Si(CH₃)₂O]_n-H) is non-reaction, it's volatile anytime and everywhere. For example, when the electric products which has been put in a confined space, the volatile of low-molecular-weight siloxanes will makes the electric products uncontacted.

Thermal Resistance vs. Pressure vs. Deflection

